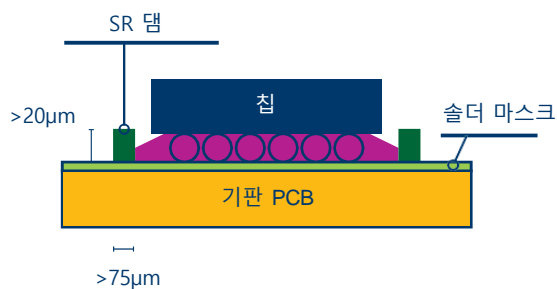


Orbotech Magna™

IC 패키징용 적층 프린팅 솔루션

더 적은 공간에 더 많은 기능 수용

마이크로 전자공학에 대한 수요 증가로 인해 기능별로 다이 주변에 배리어(Barrier)를 생성하여 다이 영역 외부로 누출을 방지할 수 있도록 비용 효율적으로 정확한 위치에 댄을 생성할 필요가 생겼습니다. 잉크젯 프린팅은 패키지 공간을 절약하면서 기존의 값비싼 솔더 마스크 패턴 형성 또는 잉크 디스펜서에 대한 대안이 될 수 있습니다.



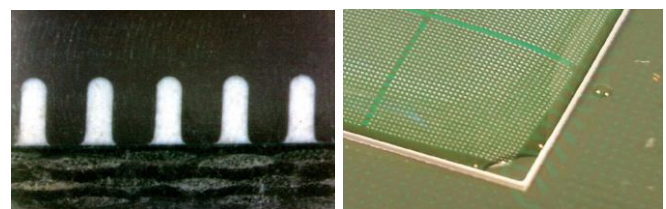
댄용 Orbotech Magna

KLA의 적층 프린팅 기술은 주변 다이 영역을 차단하는 보호 장벽을 증착하여 공간과 비용을 절약할 수 있도록 합니다. Orbotech Magna의 잉크젯 프린팅을 이용하여 댄을 형성하면 기존 공정보다 더 적은 비용으로 더 정확한 결과를 얻을 수 있습니다. 또한 Orbotech Magna는 패키지 공간을 절약할 수 있으며 플립칩 칩 스케일 패키지(FCCSP), 볼 그리드 어레이(BGA) 및 고급 CIP 모듈에 적합합니다.

- 댄용 고급 잉크젯 프린팅
- 높이 0.5mm, 폭 75µm까지 큰 종횡비로 높은 댄 증착 가능
- 다양한 기판에 우수한 접착력 제공
- 스트립, 패널, JEDEC 트레이, 웨이퍼 지원
- 높은 생산량, 낮은 총소유비용(TCO)
- 고정밀 증착으로 댄 KOZ(Keep-off Zone) 감소

절연층 직접 프린팅용 Orbotech Magna

- 자재 낭비가 없음
- 값비싼 리소그래피(Lithography) 공정 제거 - 공정 단순화
- 마스크 불필요
- 총 비용 40% 절감
- 신제품 출시(NPI)를 위한 시장출시시간(TTM) 단축
- 라우팅 가능한 QFN(Quad-Flat No-Lead) 및 CSP(Chip-Scale Package)



기존 공정 - 길고 & 고비용



Orbotech Magna - 빠르고, 비용 효율적이며 친환경적



사양

최대 프린팅 면적	12" x 16" (304.8mm x 406.4mm)
최소/최대 스트립 두께	4-256mil (0.1mm - 6.5mm)
최소/최대 해상도	600 - 2400 dpi
최소 라인	2.9mil (75µm)
위치 정밀도 (FTG)	±1.4mil (±35µm)
최대 거리 PH/기판	Up to 60mil (1.5 mm)
정렬	사용자가 선택 가능한 정렬 포인트; 부분 스케일링
스트립/패널 부착	표준: 진공 + 클램프를 처리하는 스트립 옵션: 주문형 캐리어, JEDEC, 패널
소프트웨어	소프트웨어 RIP - CAM에 통합, Gerber RS-274X 입력, 푸시 투 프린트(Push-to-print), 다국어
잉크젯 유체	주요 자재 공급업체의 다양한 유체
치수 W x D x H*	39.4" X 45.3" X 88.2" (1000mm x 1150mm x 2240mm)
중량	1984lbs (900kg)
자동화	타사 장비 통합을 통한 자동화 지원

* 시스템 상태 표시등을 포함한 높이

등이 있습니다.

© 2022 KLA Corporation. 전 세계 모든 국가에서 저작권이 보호됩니다. KLA는 예고 없이 하드웨어 및/또는 소프트웨어 사양을 변경할 수 있습니다. Orbotech는 KLA 회사인 Orbotech Limited의 등록 상표이며, KLA와 KLA 로고는 KLA Corporation의 등록 상표입니다. 모든 브랜드 또는 제품 이름은 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

One Technology Drive
Milpitas, CA 95035
www.kla.com

Rev 3.0_6-13-2022